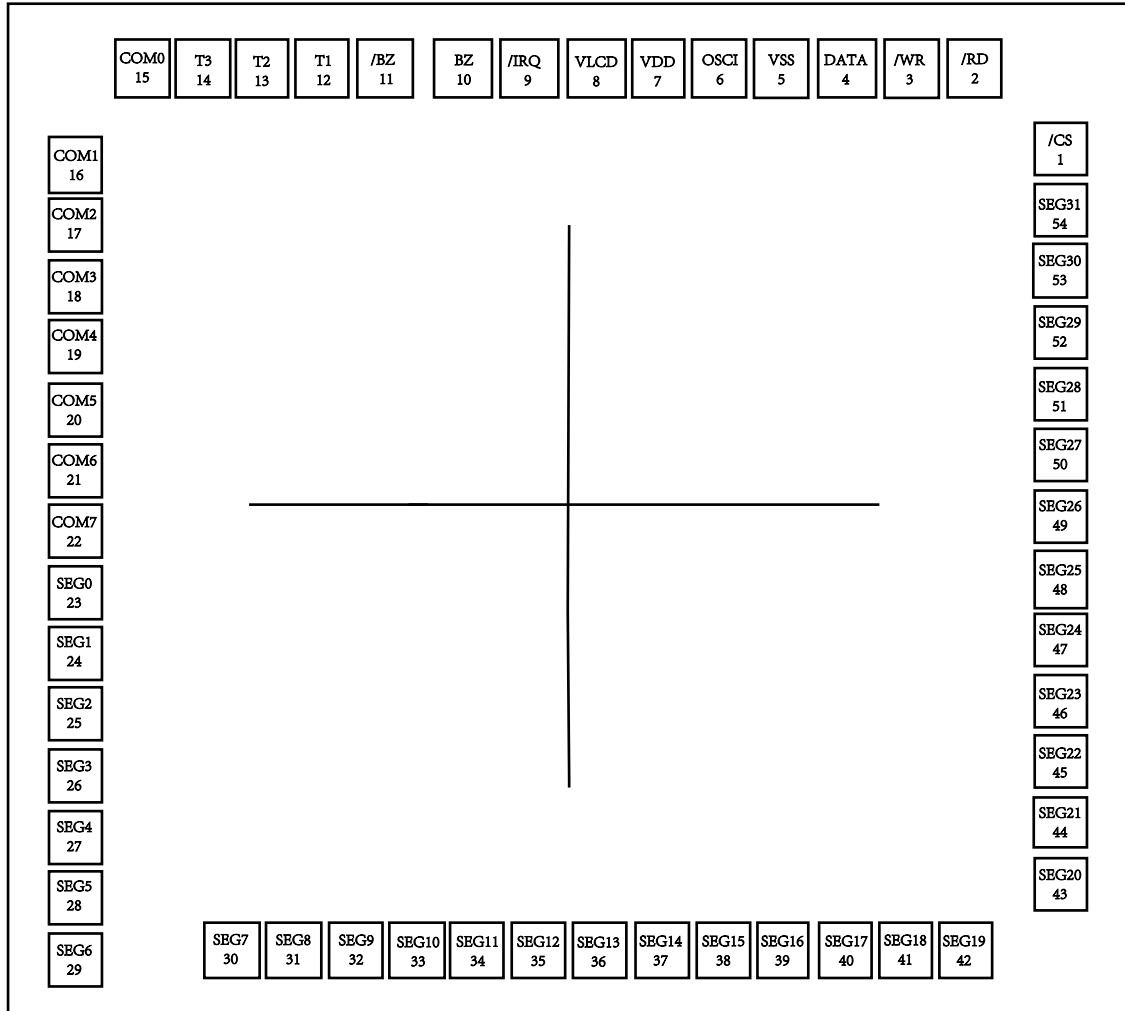


# VK1622B COB资料

## COB PAD图



芯片面积: 2080×1895 um<sup>2</sup> , 衬底电位: VDD

PAD 大小: 90×90 um, 间距: 112 um, 铝垫大小: 100×100 um, 铝垫厚度: 1um

## COB PAD坐标

(坐标原点在芯片中心, 单位:  $\mu\text{m}$ )

序号	名称	X坐标	Y坐标	序号	名称	X坐标	Y坐标
1	/CS	885	646.9	28	SEG5	-885	-701.8
2	/RD	730.2	792.5	29	SEG6	-885	-811.8
3	/WR	620.2	792.5	30	SEG7	-603.1	-792.5
4	DATA	494.1	792.5	31	SEG8	-493.1	-792.5
5	VSS	377.1	792.5	32	SEG9	-383.1	-792.5
6	OSCI	267.1	792.5	33	SEG10	-273.1	-792.5
7	VDD	157.1	792.5	34	SEG11	-163.1	-792.5
8	VLCD	47.1	792.5	35	SEG12	-53.1	-792.5
9	/IRQ	-63.5	792.5	36	SEG13	56.9	-792.5
10	BZ	-185.8	792.5	37	SEG14	166.9	-792.5
11	/BZ	-312.9	792.5	38	SEG15	276.9	-792.5
12	T1	-433.2	792.5	39	SEG16	386.9	-792.5
13	T2	-543.2	792.5	40	SEG17	496.9	-792.5
14	T3	-653.2	792.5	41	SEG18	606.9	-792.5
15	COM0	-763.2	792.5	42	SEG19	716.9	-792.5
16	COM1	-885	618.2	43	SEG20	885	-673.1
17	COM2	-885	508.2	44	SEG21	885	-563.1
18	COM3	-885	398.2	45	SEG22	885	-453.1
19	COM4	-885	288.2	46	SEG23	885	-343.1
20	COM5	-885	178.2	47	SEG24	885	-233.1
21	COM6	-885	68.2	48	SEG25	885	-123.1
22	COM7	-885	-41.8	49	SEG26	885	-13.1
23	SEG0	-885	-151.8	50	SEG27	885	96.9
24	SEG1	-885	-261.8	51	SEG28	885	206.9
25	SEG2	-885	-371.8	52	SEG29	885	316.9
26	SEG3	-885	-481.8	53	SEG30	885	426.9
27	SEG4	-885	-591.8	54	SEG31	885	536.9